# NADA-ELITE SORTER 使用手册

型號: N3-150

版本: V1.0.1.22

客戶: 新唐

### 目錄

• Chapter1: sorter 簡介

• Chapter2: sorter 系統操作界面

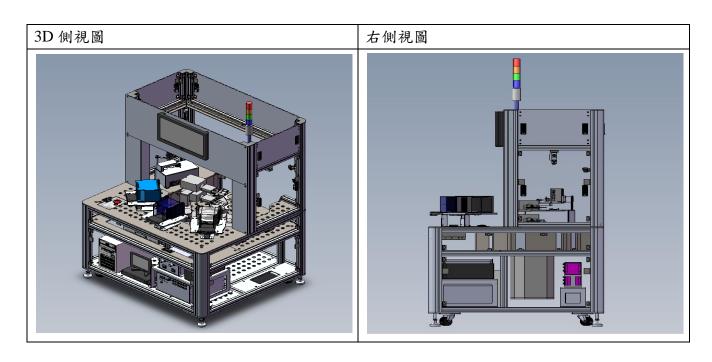
• Chapter3: sorter 使用說明

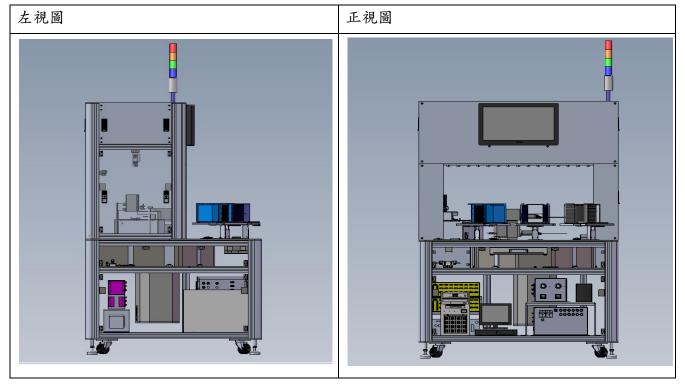
• Chapter4:故障訊息說明

• Chapter5: 附件

# Chapter 1 sorter 簡介

# 外觀圖





# 操作簡介

透過NADA sorter 軟體為操作介面,以控制機械手臂搬取晶圓。 在系統畫面中可選取指定晶圓、搬運至指定位置。

### sorter 組件

Nada sorter是一個晶圓搬運的工具,需由一個內部的電控盤轉換電源提供機械手臂、晶圓校正器、各類感知器...等。透過電腦使NADA sorter 軟體為操作介面,以控制機械手臂搬取晶圓

### 組件示意圖

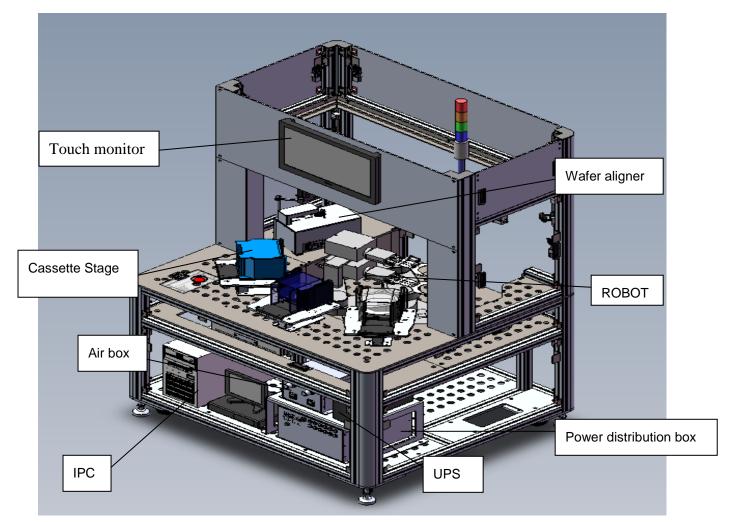


Figure 1-2. NADA-Elite sorter Front-right View

#### 晶片盒

在系統中將會讀取 RFID 定義晶片盒的代號,例如晶片盒置放於 STAGE 上即為 PORT A。透過機械手臂搬運晶圓從 A->B 或 B->A。

PORT 上 CASSETTE 晶片盒掃瞄後將定義晶圓的數量、編號,由下而上依序為 1-25。

# Sorter系統啟動/關閉流程

### 啟動程序

- 1.總電源(110 VAC RMS @ 60Hz, 15 Amperes.)
- 、真空(18-25 hg/inch)和CDA輸入



2. 開啟電源開關



3.開啟UPS後再開啟工業電腦,因不斷電系統 為保護工業電腦。

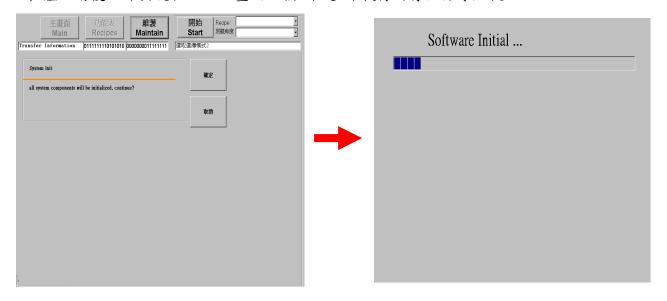


4.電腦開機後,於主畫面選取 NADA-SORTER 軟體

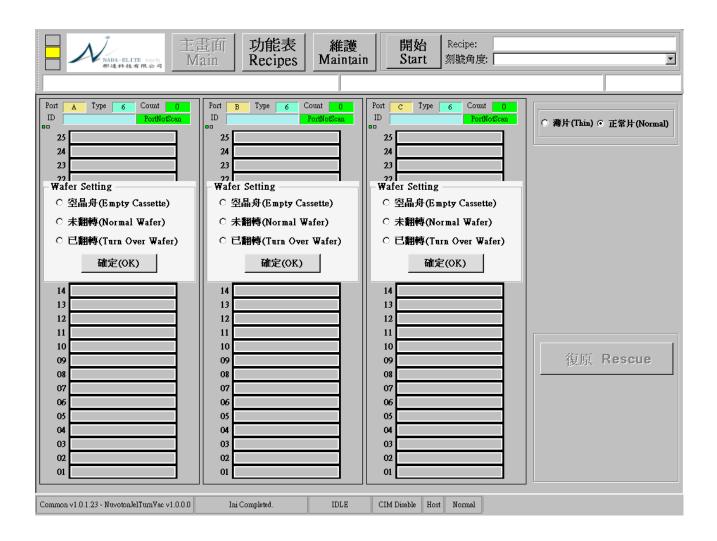




5.軟體啟動後,即出現初始化之畫面,按"確定"即執行所有組件原點校正。

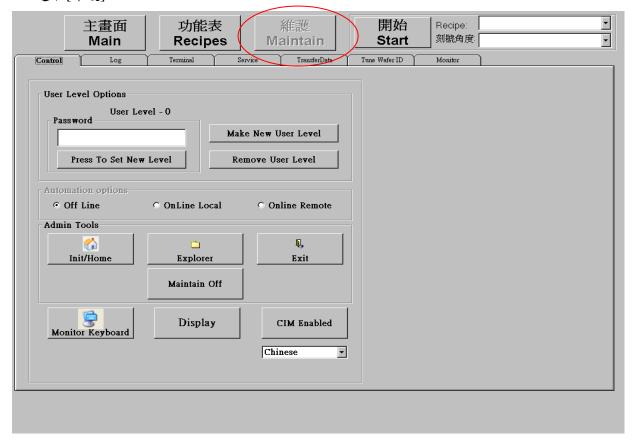


6.初始化完成後,軟體畫面將轉換為操作主頁面機械手臂、aligner原點校正完畢,轉為工作模式。

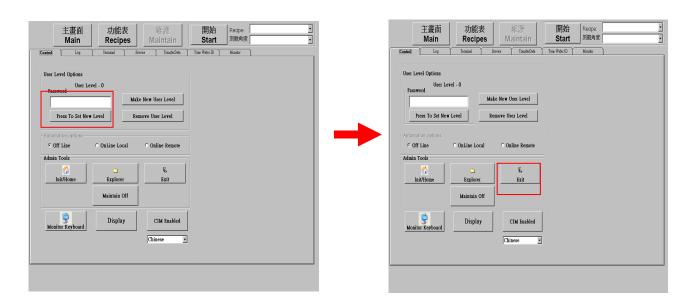


### 關閉程序

1. 選取[維護]



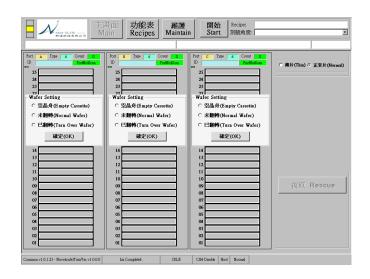
2. 輸入密碼後 press "Enter" then "Exit" NADA software (password: a0)



3.關閉電腦後關閉UPS,再關機台主電源開關。

# Chapter 2 系統操作界面

#### 1. 主畫面模式



- 1.系統完成初始化後即進入此頁面。
- 2.包含機台各項狀態,如晶圓尺寸、 晶片盒尺寸、晶圓片數.... 等。
- 3.使用"手動傳送"時,需選擇晶片、 位置。
- 4.機械手臂搬運晶片時自動進入此 頁面。

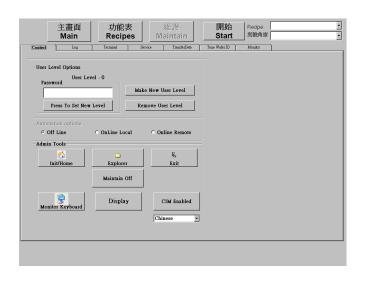
#### 2.功能表模式



#### 1. 將動作組合為程式

- 如"A->B 合併"=將port A 晶片盒內 所有晶片搬運至 B。
- 2. 各程式表示各不同之動作組合。 可依實際需求作修改、編緝。

# 3.維護模式



#### 1. <CONTROLL>

輸入密碼改變權限、系統初始 化、離開系統…. 等功能。 2. <LOG>

記錄系統所有動作、訊號。

3. <Moniter>

Input/output 監控。

# Chapter 3 使用說明

#### 功能表模式:



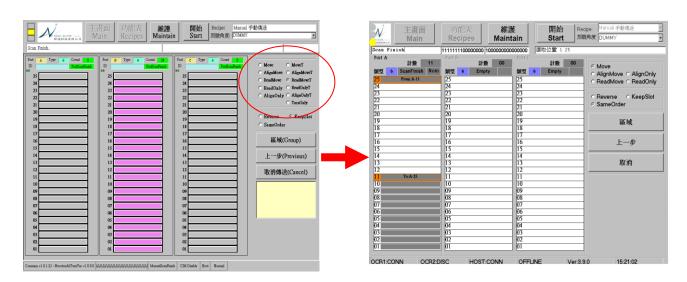
step1:選擇"程式",如"A\_尋邊"

step2:按下"開始"後,機械手臂掃瞄

PORT 上 CASSETTE 晶片盒,

後讀取所有晶片位置 mapping data。

### Manual 手動傳送模式:



Step1:選擇"Manual 手動傳送"

Step2:按下"開始"後,機械手臂掃瞄後讀取所有晶片位置 mapping data。

Step3:選擇"動作項目","排列方式"

Step4:滑鼠左鍵點選欲搬運之晶片後,再點選欲放置之位置(已有晶片之slot點選無效)。

Step5:將會顯示"to" 和"from"

Step6:按下"開始",機械手臂即開始搬運晶片。

#### **★**Port information bar



1.類型:目前所選晶片尺寸

2.計數:掃瞄後之晶片數

3.晶片盒狀況:

empty=無晶片盒,

scaning=掃瞄中,

scanfinish=掃瞄完畢

#### **★**Quick Function selector (Customization)



SetWafer: 設定stage端的晶片位置。

Move:轉換晶片位置。

Reverse:從選擇的位置往下之順序擺放晶片。

KeepSlot: 只能搬運至相同slot的晶片。

SameOrder:從選擇的位置往上之順序擺放晶片。

區域:集體選片。



快選窗:可直接選取程式。

1.Recipe: 顯示目前選取的程式。

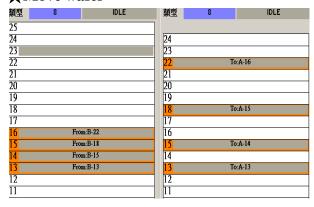
2.刻號角度:依不同刻號碼數、角度作選擇

#### **★**Select wafer

09	09
08	08
07	07
06	06
05	05

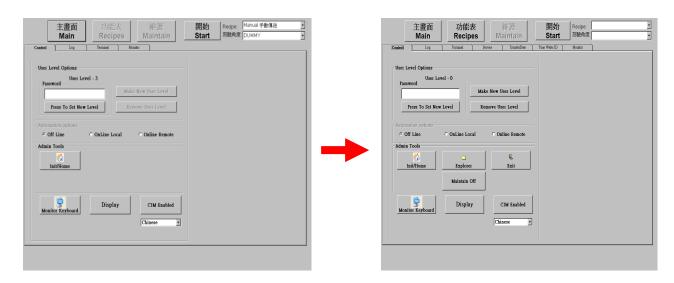
使用使用滑鼠左鍵選擇晶圓,點選後會出現紅框包圍。

#### **★**Move wafer



- 1. 滑鼠左鍵點選欲搬運之晶片後,再點選欲放置之位置(已有晶片之slot點選無效)。
- 2.將會顯示"to" 和"from"
- 3.按下"開始",機械手臂即開始搬運晶片。

## 維護模式功能說明



#### **User level options**



可區分不同權限的使用者,如操作員,工程師...等。 透過權限上管理,系統開放不同的功能。

初始密碼:a0

#### **★**Admin tools-init/home



初始化系統,包括Robot/ALIGNER 原點校正。

#### **★**Admin tools-Explorer



檔案管理員。

#### **★**Admin tools-Exit



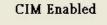
離開nada sorter軟體。

#### **★**Key board



螢幕小鍵盤

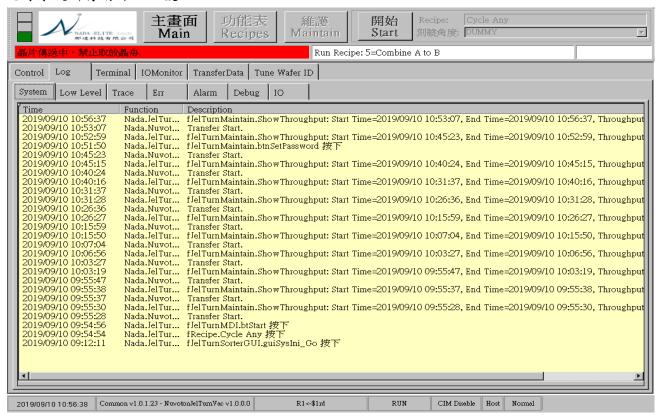
#### **★**CIM Enabled



Trigged CIM function before choice CIM Mode

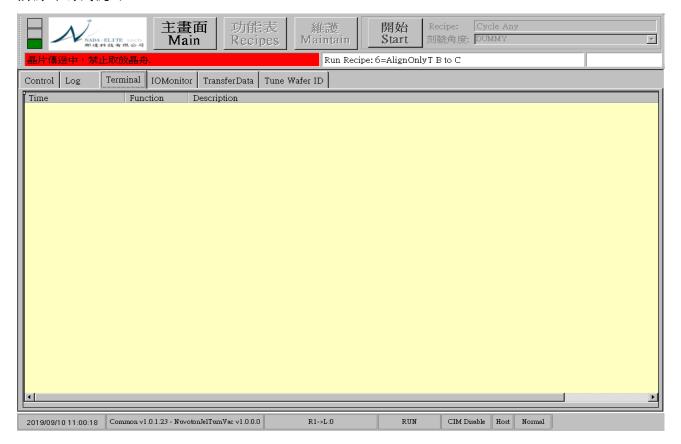
#### Log page

記錄系統所有動作、訊號



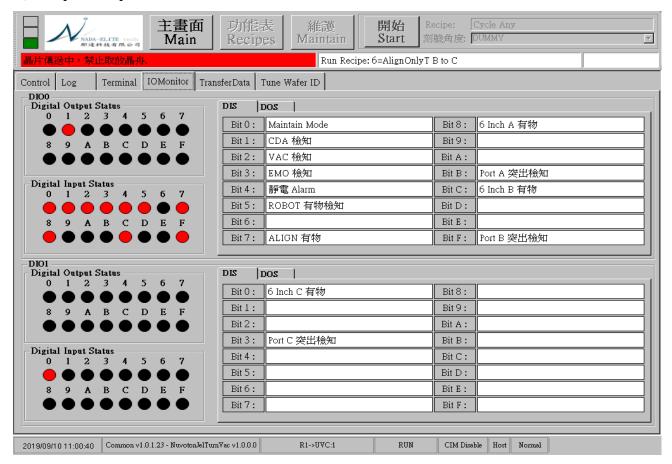
#### Terminal page

預備終端機使用



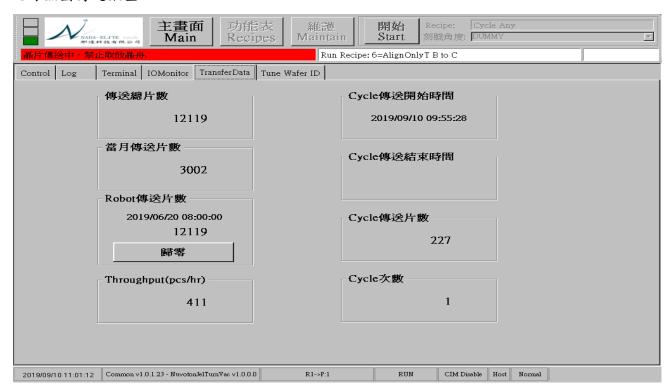
#### **IO** monitor page

機台 Input/Output 數位信號顯示

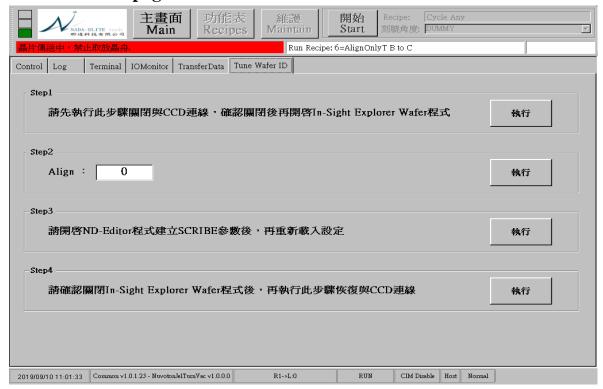


#### Transfer data page

記錄晶圓傳送數量



### **Tune Wafer ID page**



## Step 1

1、 請利用手動Align Only或Read Only傳片至晶圓轉正器使晶圓停置上方後按<mark>停止</mark>。



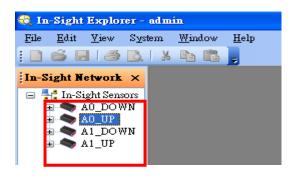
2、 點選執行關閉CCD連線。

請先執行此步驟關閉與CCD連線,確認關閉 後再開啓In-Sight Explorer Wafer程式 執行

3、 切勿關閉Nada主程式,只開啟Window畫面並選取 In-Sight Explorer Wafer。



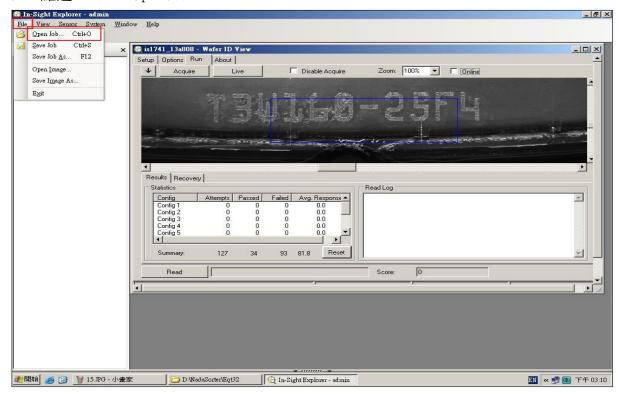
4、開啟程式並選擇左上或左下CCD。又或者選右上或右下CCD。



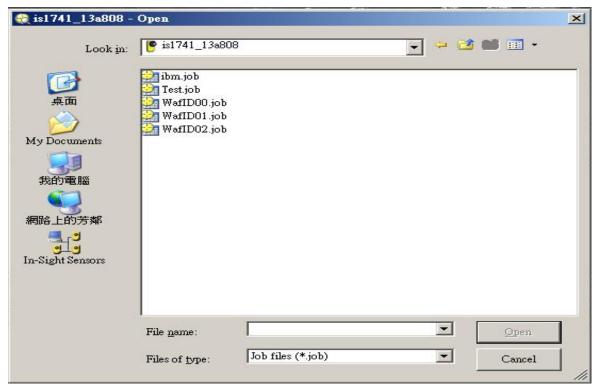
5、取消 Online方可進行後續 Tuning 設定。



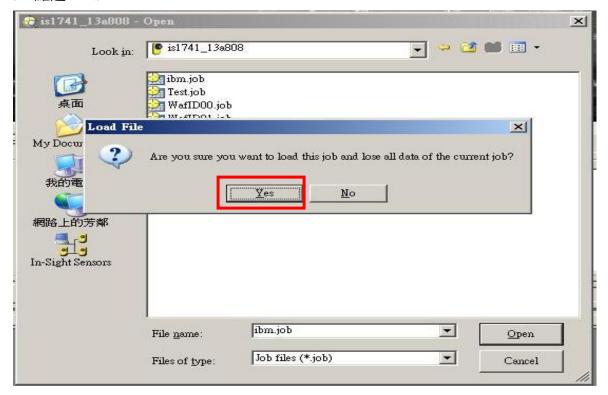
6、點選 File --> Open Job。



7、選擇需要重新Tuning的檔案。



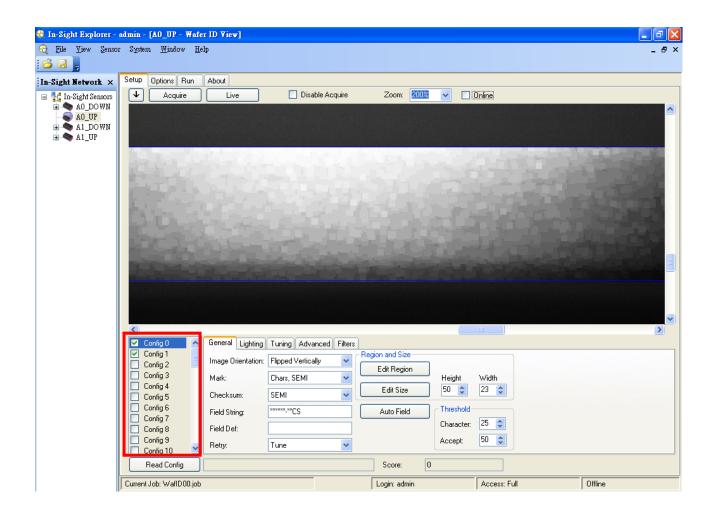
#### 8、點選 YES。



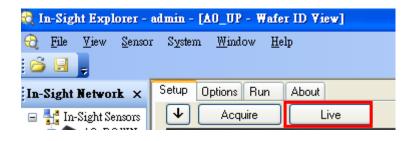
9、點選 Setup 進入設定頁面。



10、選擇欲修改或新增讀取的 Config。點選 "Set-up" 頁面,選擇相對應的 Config;(一個 OCR file \*.job 其中包含 50 組的 config)



### 11、點選 Live ( 即時影像 )

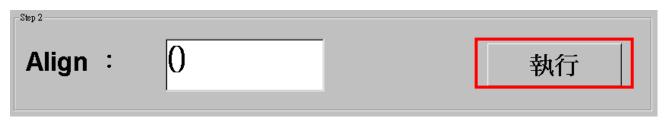


## Step 2

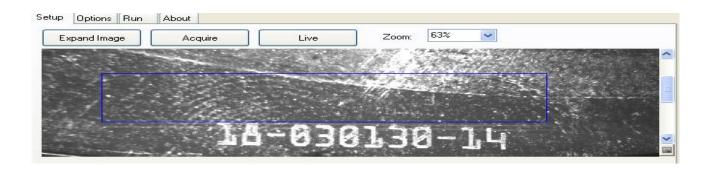
1、 在即時影像中配合Step 2 Align功能點選執行尋找最適合的讀取刻號角度。

備註 1:參數0為0度,參數100為1度,參數1000為10度。

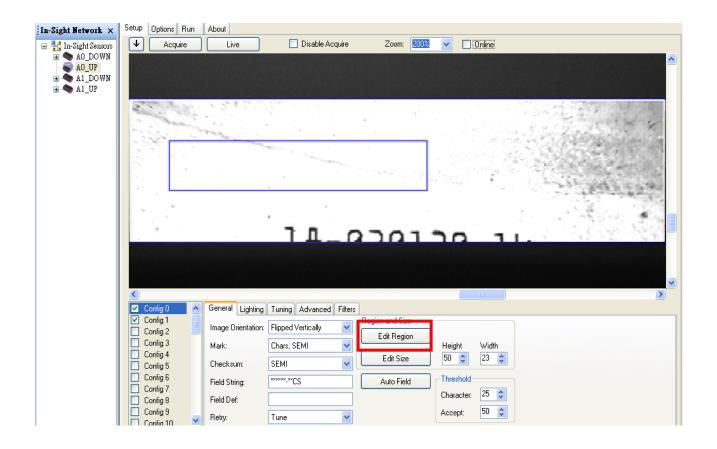
備註 2: 正數往順時針移動,負數往逆時針移動。



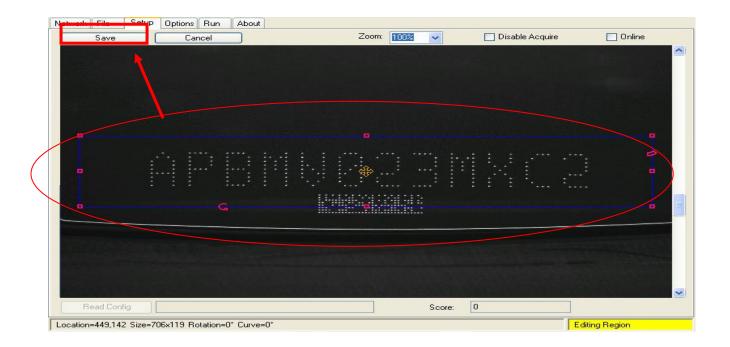
2、配合Step 1-9 檢視即時影像是否看見刻號。如刻號顯示於CCD置中畫面即是正確。 需記錄CCD可讀取Align的角度。以便後續在Scribe的設定。



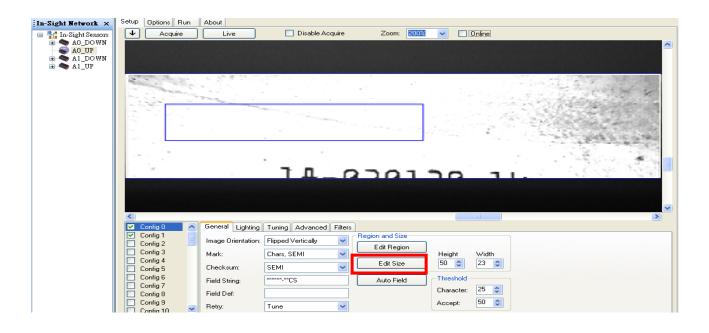
3、回Setup頁面並選取Edit Region。



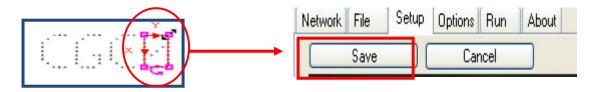
4、 將框框置入刻號適當範圍後並Save。(字元焦距如下圖有一點一點的顯示為最佳顯示)



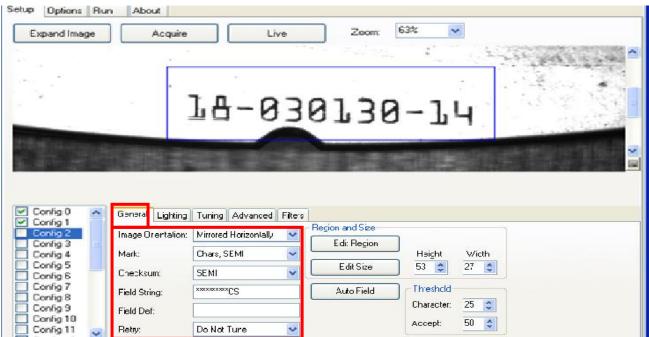
5、回Setup頁面並點選 Edit Size。

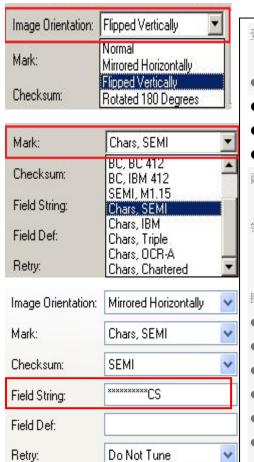


6、Edit Size 是將框圈選一個字元線條上。此框強烈建議圈選這三個字元為 數字0、英文O、8。 完成後再Save儲存。



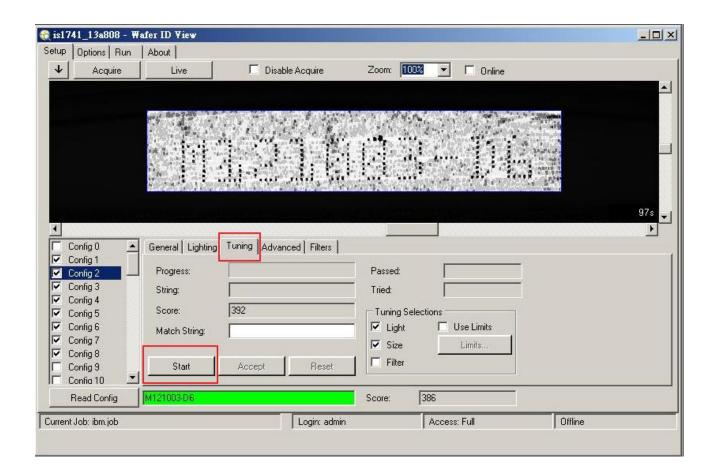
7、回 Setup頁面並點選General調整設定



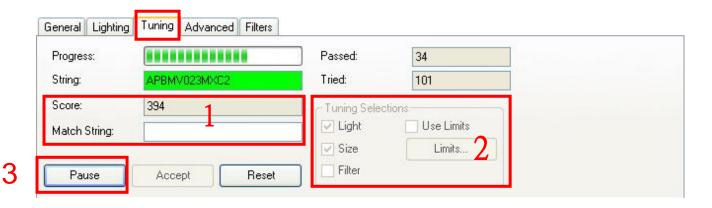


8、點選 "Tuning" --> "Start"

- 壹、Image Orientation:選擇的圖像中的標示取向。使顯示 方向為正常。
- Normal:未修改的影像。
- Mirrored Horizontally:修改成左右影像。
- Flipped Vertically:修改成垂直翻轉影像。
- Rotated 180 Degrees:修改成旋轉 180 度影像:
- 貳、Mark:指定晶圓類型標記的配置讀取。一般選擇 Chars, SEMI。
- Checksum:選擇從其中字串的讀出結果驗證。確保評分依據所讀取的狀態。一般選擇 SEMI with Virtual (滿分 400)或是 Virtual (滿分 200)。
- 肆、Field String:指定字元編碼。
- 英文:A
- 數字:N
- 萬用字:\*
- Dashes : -
- Dots:.
- CS:最後兩碼如鍵入 CS 則有 CheckSum 功能。
- 範例: AB123-07A5 → AANNN-NNCS 或\*\*\*\*\*-\*\*CS
- 伍、 Retry: 讀取機時,再次 Tuning 讀取刻號。



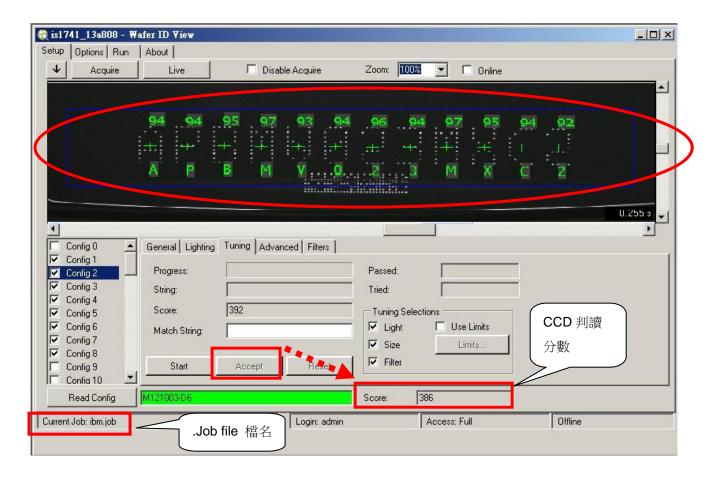
9、點選Tuning 進入頁面 (下圖為Tuning過程圖)



1. Score: SEMI with Virtual (滿分 400)或是 Virtual (滿分 200)。

Match String:如鍵入該晶圓正確刻號可提高第一次tuning之效率。空白亦可。

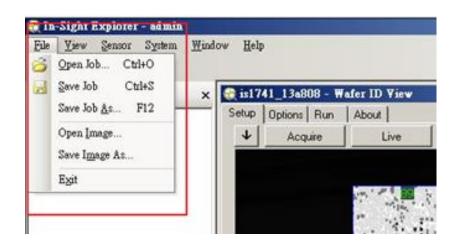
- 2. Tuning Selections: 點選 Light 與 Size。 Filter 與 Use Limits則不勾選。
- 3. 點選 Start 啟動自動Tuning。 Tuning過程中會顯示成 Pause。
- 10、 Tuning完成顯示圖。(正常為綠十字於字元中央,異常為紅十字不於字元中央,需重新調整Region、Size。) Tuning完成後點選Accept可看CCD判讀分數。



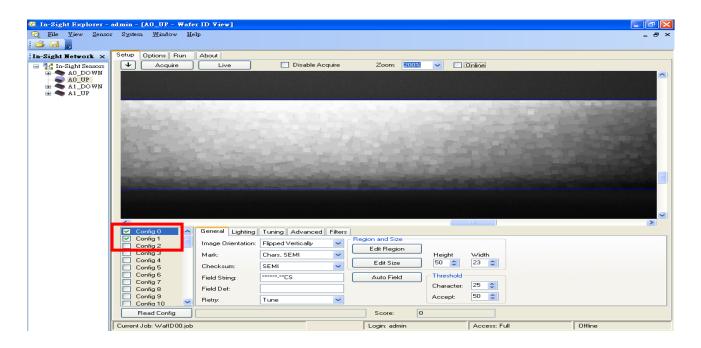
#### 11、存檔。

點選 File --> Save Job.( 存回原本的 Job file)

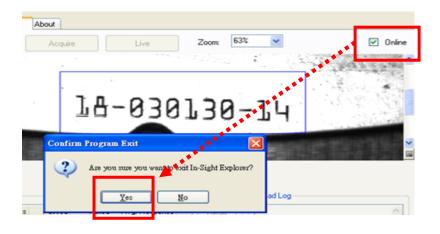
點選 File --> Save Job As...(另存新的 Job file)



12、 設定完成且欲使用之 CONFIG 需打勾。不使用的 CONFIG 則不需打勾。

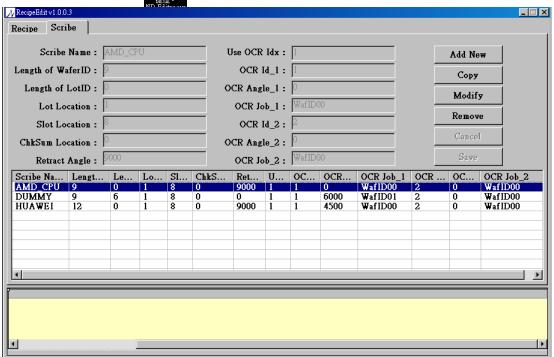


13、離開 In-Sight Explorer 軟體前需勾選Online後方可離開軟體。



# Step 3

開啟ND Editor程式 ,點選"Scribe"設定刻號角度、刻號的字串。



#### **★ND Editor-Scribe**

Addnew	Editor button
Сору	Addnew:新增
Modify	Copy:複製
Remove	Modify: 修改
Cancel	Remove: 移除
Save	Cancel: 取消

Save: 儲存

#### **★ND** Editor-Scribe list

Scribe Na	Lengt	Le	Lo	Sl	ChkS	Ret	U	0C	OCR	OCR Job_1	OCR	0C	OCR Job_2
AMD_CPU	9	0	1	8	0	9000	1	1	0	WafID00	2	0	WafID00
DUMMY	9	6	1	8	0	0	1	1	6000	WafID01	2	0	WafID00
HUAWEI	12	0	1	8	0	9000	1	1	4500	WafID00	2	0	WafID00
1													

#### **★**ND Editor-Scribe setting

Scribe Name :	Use OCR Idx:
Length of WaferID:	OCR Id_1 : 1
Length of LotID:	OCR Angle_1:
Lot Location:	OCR Job_1 : WafID00
Slot Location:	OCR Id_2: 2
ChkSum Location:	OCR Angle_2:
Retract Angle:	OCR Job_2 : WafID00

Scribe Name: scribe名稱,以區分不同產品、客戶、尋邊角度。

Length of WaferID:刻號的字元數, Max=19,空白、-也算一個字元。

Length of lotID: 批號的字元數

Lot location: 批號的位置。

Slot location:序號的位置(01 thru 25).

Check Sum Location: Check Sum function的位置。

Retract angle:機械手臂從晶圓校正器取出時,校正器調整平邊的角度。

Use OCR Idx:使用OCR代號。

OCR Id\_1: 第一台OCR的代號 。

OCR angle\_1: 第一台OCR的角度設定,晶圓校正器調整平邊的角度或鏡頭可讀取刻號的角度。

OCR Job\_1: 第一台OCR對應的工作目錄代碼。

OCR Id 2: 第二台OCR的代號。

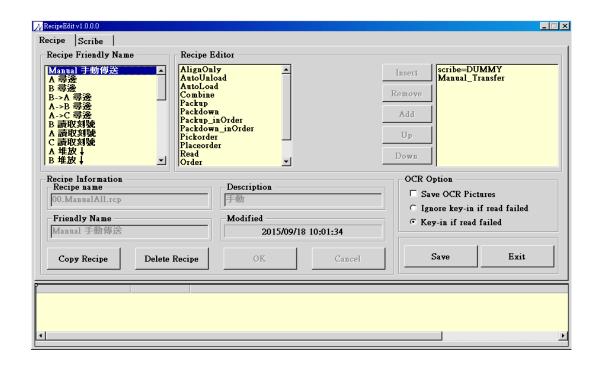
OCR angle\_2: 第二台OCR的角度設定,晶圓校正器調整平邊的角度或鏡頭可讀取刻號的角度。

OCR Job\_2: 第二台OCR對應的工作目錄代碼。

#### Set Scribe configuration instruction

Scribe	Α	В	1	2	3	4	5	-	0	1	Α	7
Length of scribe	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Length of lot	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Lot location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ID location	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Check Sum	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Step 3.1點選"Recipe"為動作之組合,依需求可編緝、修改。



Step3.2.複製任一原存在之程式/選擇欲修改之程式



Recipe name: 程式檔名

Description: 描述程式的內容

Friendly Name: 可自行定義,顯示於"功能表"頁面

Modified:修改時間 Copy recipe:復製程式 Delete recipe:刪除程式

Step3.3. 修改"Friendly Name",顯示於主畫面之名稱



Step3.4. 在"Recipe Editor"選擇功能加入/修改



Recipe Editor, list commands for Recipe creation

tecipe Baitor, inst con	imanus for Recipe creation
Command	description
Alignonly	只調整平邊
Autounload	自動載出
Autoload	自動載入
Combine	合併
Cycle	循環測試
Order	讀取刻號+依序排列
Packdown	向下壓縮(最上放到最下)
packup	向上壓縮(最下放到最上)
Packdown_inorder	依序向下壓縮
Packup_inorder	依序向上壓縮
Pickorder	取片的順序,從最上、最下、原 slot
Placeorder	放片的順序,從最上、最下、原 slot
Read	只讀取刻號
Scribe	刻號角度、字串構造設定有 read、order、align
	等動作均需設定
Reserve	Reserve port slot to hold the slot
Manual_transfer	手動傳送 fro
	m/to

#### Step3.5



Save OCR Pictures:儲存刻號照片

Ignore key-in if read failed:關閉手動Key-in視窗

Key-in if read failed:開啟手動Key-in視窗

Save → exit , 離開 "ND Editor"

執行Step 3.後系統將設定載入



### Step 4

執行Step 4後,CCD恢復連線,將Wafer自動回復傳回Cassette完成Tune Wafer ID,後主程式進行initial,將所有設定更新。



# Chapter4 故障訊息說明

# system alarm code

code	mas	ssage	action
1	Put Error	PUT動作錯誤警告	Retry
			確認晶圓是否在手臂上
2	Get Error	GET 動作錯誤警告	Retry
			確認robot get position
			確認真空狀態
3	Obstacle Detected Alarm	障礙物感知啟動	檢查是否有晶圓突出
			系統初始化
4	Start Turn Right Alarm	電源開關異常	檢查電源開關
			系統初始化
5	EMO Alarm	EMO異常	檢查EMO按鍵
			系統初始化
6	Vacuum Source Abnormal	真空來源異常	檢查真空來源
			系統初始化
7	Cassette Abnormal Load	Cassette異常載入	檢查INDEXER
			系統初始化
8	Cassette Abnormal Unload	Cassette 異常載出	檢查 INDEXER
			系統初始化
9	robot Error	手臂異常	檢查robot
			系統初始化
10	Cassette No Safety	Cassette狀態異常	檢查STAGE 端是否有晶圓
			檢查晶圓感知是否啟動
			系統初始化
11	Transaction Error	通訊交握異常	<b>系統初始化</b>

# **Chapter 5 Appendix**

# **Appendix-1 Robot Parameter**

# 1.Robot 點位儲存區塊規畫

I	BANK	ALIGN	PORT A	PORT B	PORT C
上	Cst1 正常 WAFER	=	2	3	4
blade	Cst2薄 wafer	5	6	7	8
下	Cst1 正常 WAFER	G	9	A	В
blade	Cst2薄 wafer	С	D	E	F

# 2.Robot GET/PUT點位規畫

Teaching	上t	olade	下blade		
Point	GET(LOW)	PUT(HIGH)	GET(LOW)	PUT(HIGH)	
	Slot (1~25)	Slot (1~25)	Slot (1~25)	Slot (1~25)	
正FLIP	26~50	56~80	326~350	356~380	
反FLIP	86~110	116~140	386~410	416~440	

# Appendix-2 主件清單

料號	品名	數量
A02002500009	JEL robot	1
C05000900005	ISEL Aligner	1
D24002400003	Stage	3
C09000100040	工業電腦	1
C11000100001	Cognex 1721	1
M22002700063	UPS	1
M22999900381	静電消除器	1
D22003500013	POWER BOX	1
D24000100137	陶瓷BLADE	2
M22999900613	監控系統主機	1
M22999900576	監控系統鏡頭	2
M22001000033	監控系統螢幕	1
	A02002500009 C05000900005 D24002400003 C09000100040 C11000100001 M22002700063 M22999900381 D22003500013 D24000100137 M22999900613 M22999900576	A02002500009

# Appendix-3 JEL ROBOT Macro 指令表

PRI 指令	ном	WOB	SCAN
JEL指令	\$1G301	\$1G303	\$1G306

SLOT1~SLOT25	正FLIP GET	正FLIP PUT	反FLIP GET	反FLIP PUT
上 <b>GET/PUT</b>	\$1G1~25	\$1G26~50	\$1G51~75	\$1G76~100
下 <b>GET/PUT</b>	\$1G101~125	\$1G126~150	\$1G151~175	\$1G176~200

# Appendix-4 JEL ROBOT teaching data backup

ARM			R 軸位置(rara)				T 軸位置(ram)				Z 軸位:置(rara)			
			正面		反面		正面		反面		正面		反面	
Port	Amuup	BANK	L(GET)26	H(PUT)56	L(GET)86	H(PUT)116	L(GET)26	H(PUT)56	L(GET)86	H(PUT)116	L(GET)26	H(PUT)56	L(GET)86	H(PUT)116
	Arm Down		L(GET)326	н(РИТ)356	L(GET)386	H(PUT)416	L(GET)326	H(PUT)356	L(GET)386	H(PUT)416	L(GET)326	н (РИТ) 356	L(GET)386	H(PUT)416
	Arm Up	2	93			234.694			14.26	16	10.9	11.8		
	Arm Down	9	93				234.842				132.5	134.3	128.95	129.7
	SCAN 552	9	-305.9			54.7			125.71					
В	Arm Up	3	93.3				274.56			14.5	16.3	11.1	12.1	
	Arm Down	А	93.5			274.8			132.7	134.5	129.2	130		
	SCAN 552	А	-306.38			94.927			126.615					
С	Arm Up	4	93.5				314.72			14.2	16.1	11	11.9	
	Arm Down	В	93.5			314.85			132.6	134.5	128.7	129.8		
	SCAN 552	В	-306.4			134.981			126.378					
Aligner	Arm Up	5	135.267			170.287			29,492	31.692	26.115	27.832		
	Aım Down	С	135.647			170.366			146.104	149.9	143.72	145.198		



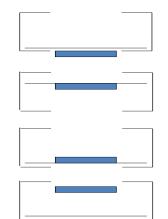
# 上blade GET/PUT 校正相對位置

正FLIP GET Point PM=26

正FLIP PUT Point PM=56

反FLIP GET Point PM=86

反FLIP PUT Point PM=116



Blade 距離wafer下2mm 設定Z軸高度

Blade抓取wafer放置Slot 中間偏上設定Z軸高度

Blade平貼wafer抓取設定 Z軸高度

Blade離開wafer放置Slot 中間偏上設定Z軸高度



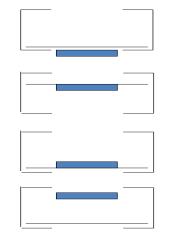
## 下blade GET/PUT 校正相對位置

正FLIP GET Point PM=326

正FLIP PUT Point PM=356

反FLIP GET Point PM=386

反FLIP PUT Point PM=416



Blade 距離wafer下2mm 設定Z軸高度

Blade抓取wafer放置Slot 中間偏上設定Z軸高度

Blade平貼wafer抓取設定 Z軸高度

Blade抓取wafer放置Slot 中間偏上設定Z軸高度